

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司 仅依据研发标准进入创新层的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司符合创新层进层标准

西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（三）款规定的进层标准，具体情况如下：

创新层进层标准	是否符合	指标情况说明
（一）最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
（二）最近两年营业收入平均不低于 8000 万元，且持续增长，年均复合增长率不低于 30%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
（三）最近两年研发投入累计不低于 2500 万元，截至进层启动日的 24 个月内，定向发行普通股融资金额累计不低于 4000 万元（不含以非现金资产认购的部分），且每次发行完成后以该次发行价格计算的股票市值均不低于 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<p>公司 2023 年、2024 年研发投入分别为 23,113.74 万元、17,949.02 万元，最近两年累计研发投入为 41,062.76 万元，不低于 2,500 万元。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 16 日完成股票定向发行相关的普通股挂牌转让工作，该次定向发行以现金方式融资 25,625.45 万元，以保留两位小数的发行价 15.08 元/股计算的公司股票市值为 18.57 亿元。</p> <p>截至进层启动日的 24 个月内，公司定向发行普通股融资金</p>

创新层进层标准	是否符合	指标情况说明
		额累计大于 4,000 万元，全部以现金方式认购，且以发行价格计算的发行完成后的股票市值大于 3 亿元。
（四）截至进层启动日的 120 个交易日内，最近有成交的 60 个交易日的平均股票市值不低于 3 亿元；采取做市交易方式的，截至进层启动日做市商家数不少于 4 家；采取集合竞价交易方式的，前述 60 个交易日通过集合竞价交易方式实现的股票累计成交量不低于 100 万股；截至进层启动日的股本总额不少于 5000 万元	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符情况，均为四舍五入原因造成。

综上，公司满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七（三）款规定的进层标准，并拟仅根据研发标准进入创新层。

二、报告期内研发投入总额、开支范围、归集标准和需要履行的审批程序

（一）研发投入总额

单位：万元

项目	2024 年发生额	2023 年发生额
职工薪酬	12,390.10	15,136.00
折旧与摊销	2,917.59	5,207.18
借机测试费	1,350.24	963.38
物料消耗费	747.69	1,025.44
水电及物业费	263.88	291.56
其他	279.52	490.17
合计	17,949.02	23,113.74

（二）公司研发支出开支范围及归集标准

1、研发支出性质

根据公司财务核算制度，公司研究开发活动定义为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进

行的具有明确目标的活动。

2、分类范畴

公司研发活动可分为两大类：（1）自发研究的新技术、新产品，应进行单独立项，归集相关开支计入研发费用中；（2）对于已有的技术及产品，因产品升级改造明显提升性能、改进生产效率等技术等发生的费用，应针对改进事项进行立项，计入研发费用。

3、明确不属于研发活动的事项

研发支出不包括企业对产品（服务）的常规性升级或对某项科研成果直接应用等活动（如直接采用新的材料、装置、产品、服务、工艺或知识等）。因修复产品程序错误（Bug）或进行工厂更换而需要研发人员参与或产生费用的事由，同样不满足研发活动的范畴，无需进行研发立项，后续根据性质计入产品成本、销售费用等科目。

4、记录要求

各研发项目需要根据《企业内部控制应用指引第 10 号——研究与开发》形成立项文件、过程记录最终完成结项形成闭环。

5、具体核算标准

公司研发费用核算的主要内容包括职工薪酬、折旧与摊销、借机测试费、物料消耗费等，具体的核算内容、核算方法及分摊依据如下：

项目	核算内容	核算方法	分摊依据
职工薪酬	公司研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工相关支出。	（1）填报。研发人员根据自身参与项目填报工时，月末各项目予以归集工时情况，反馈各项目的项目经理（PM）； （2）复核。各项目经理根据填报汇总的工时情况予以复核，与实际情况有出入的，驳回员工重新修正后提交； （3）核算。人事及财务部门以整理复核后的工时为分摊原则，结合各员工薪酬计提情况，将各员工人工成本	人工工时

项目	核算内容	核算方法	分摊依据
		分摊至对应项目当中。	
折旧与摊销	主要为研发活动后端设计及试制相关固定资产折旧、无形资产摊销。其中，固定资产主要为掩模版、探针卡、测试机台，无形资产主要为芯片设计用 EDA 软件及 IP 核。	对于只能用于对应研发项目的掩模版、探针卡，直接将该固定资产折旧计入对应项目；对于测试机台等共用固定资产，按照使用该资产的研发部门，投入到各项目上的工时予以分摊。 EDA 软件及 IP 核等无形资产分摊方式与上述固定资产模式相同。	直接对应计入，或按工时分摊计入
借机测试费	主要为研发活动的封装测试环节，支付给第三方封测厂的机台使用费。	相关研发采购订单创建时即对应到具体的研发项目，可将相关耗用或费用直接计入对应项目当中。	按订单所购物料直接对应计入项目
物料消耗费	主要为研发活动的流片代工及封装测试过程中，对应的物料耗费用。		
水电及物业费	与研发用办公场地相关的水电及物业费用	各期发生金额较小，按照人员工时分摊计入项目	人员工时

6、相关会计处理

借：研发费用

贷：原材料/库存商品

应付职工薪酬

累计折旧

累计摊销

银行存款等

（三）投入核算体系与研究开发费用辅助账设置情况

本公司已建立研发投入核算体系，各研发项目已按照相关规定单独建账，并建立了研究开发费用辅助账。

综上，公司已明确研发投入范围和标准，并能够严格按照研发投入用途、性质据实列支研发投入，不存在将与研发无关的费用在研发投入中核算的情形。

（四）研究开发活动相关的内部控制制度及执行情况

公司制定《研发费用财务核算制度》、《产品研发手册》（Product Development Hand-Book）及辅助文件等研发相关制度，就包括研发支出开支范围和标准、审批程序、核算方法及依据、研发流程及控制等予以清晰明确的规定。

综上，公司已建立研发支出开支范围和标准、审批程序、有明确的组织架构和研发工作流程体系、研发支出的财务核算规范，相关内控制度已健全并被有效执行，关于研发投入的相关信息披露准确完整。

三、按照研发项目列示报告期内研发投入的归集和会计核算明细

（一）报告期内研发项目基本情况

项目名称	项目来源	目前进展
低功耗 DRAM 存储器芯片项目	自主研发	进行中
堆叠嵌入式 DRAM 项目	自主研发	进行中
标准 DRAM 存储器芯片项目	自主研发	进行中
CXL 存储控制芯片项目	自主研发	进行中
系统产品项目	自主研发	进行中
基础技术研发项目	合作研发	进行中

（二）报告期内研发投入的归集和会计核算明细

1、2023 年研发投入的归集和会计核算明细

单位：万元

项目名称	职工薪酬	折旧与摊销	借机测试费	物料消耗费	其他	小计
低功耗 DRAM 存储器芯片项目	4,519.50	483.70	108.68	106.34	292.40	5,510.61
堆叠嵌入式 DRAM 项目	1,109.20	1,882.14	86.88	366.24	36.95	3,481.41
标准 DRAM 存储器芯片项目	3,863.19	865.27	746.04	314.93	344.26	6,133.68
CXL 存储控制芯片项目	5,286.67	1,899.66	0.71	193.05	85.25	7,465.34
系统产品项目	357.44	76.41	21.08	44.89	22.87	522.70

项目名称	职工薪酬	折旧与摊销	借机测试费	物料消耗费	其他	小计
基础技术研发项目	-	-	-	-	-	-
合计	15,136.00	5,207.18	963.38	1,025.44	781.74	23,113.74

2、2024 年研发投入的归集和会计核算明细

单位：万元

项目名称	职工薪酬	折旧与摊销	借机测试费	物料消耗费	其他	小计
低功耗 DRAM 存储器芯片项目	3,131.32	1,062.55	848.40	144.70	181.70	5,368.67
堆叠嵌入式 DRAM 项目	2,220.30	111.27	-1.32	2.55	37.76	2,370.55
标准 DRAM 存储器芯片项目	4,638.69	542.63	460.84	101.55	222.54	5,966.26
CXL 存储控制芯片项目	1,944.44	984.46	10.89	382.71	73.98	3,396.48
系统产品项目	361.34	140.70	27.47	67.48	20.09	617.09
基础技术研发项目	94.01	75.98	3.97	48.70	7.32	229.97
合计	12,390.10	2,917.59	1,350.24	747.69	543.40	17,949.02

四、其他需要说明情况

公司无其他需要说明情况。

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日